

## PRESSEINFORMATION

### **Die Saki Corporation stellt auf der SMTconnect 2022 die nächste Generation von Inspektionslösungen vor**

**Genauigkeit, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit stehen im Mittelpunkt von Sakis Smart-Factory-Innovationen für hohe Produktqualität**

Tokio, Japan - 12. April 2022 - Die Saki Corporation, ein führendes innovatives Unternehmen im Bereich automatisierter optischer und röntgentechnischer Inspektionssysteme, stellt auf der SMTconnect in Nürnberg das erweiterte Portfolio von 3D-SPI, 3D-AOI und 3D-AXI Inspektionslösungen in Halle 4A am Stand Nr. 135 vor. Vom 10. bis 12. Mai lädt das Technologie-Team von Saki außerdem die Messebesucher ein, die neuesten Hard- und Software-Innovationen, darunter Sakis innovative optische Z-Achsen-Kopf-Steuerung für die 3D-AOI-Systeme sowie das 2D-AOI-System für Unterseiteninspektion und die neueste 3D-SPI-Plattform, kennenzulernen.

Mit Live-Demonstrationen bietet Saki den Standbesuchern einen direkten Einblick in die einzigartigen Eigenschaften der neuesten Hardware- und Softwareversionen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Genauigkeit, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Qualität und der Einsatzmöglichkeit für Smart-Factory-Anwendungen in allen Sektoren der Elektronikindustrie.

**Zu den Messe-Highlights gehören:**

#### **3D-AOI - 3Di-LS2 mit 12 µm Auflösung, Z-Achsen-Steuerung und seitlicher Kamera**

Sakis neue Kontrollfunktion der Z-Achse des optischen Messkopfs ist die Antwort auf die steigende Zahl von Applikationen in denen neben der Prüfung an flachen Bauelementen auch eine präzise Inspektion von höheren Komponenten, Einpressteilen und fertigen Elektronik-Baugruppen in Test-Vorrichtungen erforderlich ist. Der innovative optische Messkopf erreicht im 3D-Modus einen erweiterten Höhenmessbereich von bis zu 40 mm. Die maximale Fokussierhöhe in 2D wurde ebenfalls auf 40 mm angehoben. Mit diesen Funktionen erfüllen die Systeme der 3Di-AOI-Serie von Saki Inspektionsmöglichkeiten und Flexibilität, die weit über Standard-SMT-Inspektionsprozesse hinausgehen, mit Genauigkeit, Geschwindigkeit und Leichtigkeit.

## **3D-CT AXI - 3Xi-M110**

Sakis automatisches In-Line-Röntgeninspektionssystem für 3D-CT (AXI) von bestückten Baugruppen ist kompakt, leichtgewichtig und zudem einfach zu bedienen. Das Modell 3Xi-M110 hat eine weiter entwickelte, optimierte Software erhalten, die die Taktzeiten um bis zu 50 % verkürzt. Mit diesem AXI-System lassen sich optisch verdeckte Lötstellen für IC-Gehäuse mit unten liegenden Anschlüssen wie BGAs, LGAs, QFNs, Flip-Chips und Package-on-Package sicher inspizieren und ihre Qualität und Zuverlässigkeit überprüfen. Die genauen volumetrischen Messungen und Techniken der Formrekonstruktion ermöglichen Voids, Head-in-Pillow und andere schwer zu identifizierende Fertigungsfehler einwandfrei zu diagnostizieren.

## **3D-SPI - 3Si-LS2**

Sakis 3D-Lotpasteninspektionssystem ist mit der Zielsetzung für sehr hohe Genauigkeit und sehr große Geschwindigkeit entwickelt worden. Das Modell mit einer In-Line-Spur weist einen hochgenau arbeitenden Kamerakopf mit 12 µm Auflösung auf und eignet sich für Leiterplattengrößen im weiten Bereich von 50 mm x 60 mm bis 500 mm x 510 mm.

## **2D-AOI - 2Di-LU1 (für die Unterseiteninspektion)**

Das 2D-AOI-System 2Di-LU1 ist die erste Wahl für die automatische Prüfung der Unterseite von Elektronik-Baugruppen. Es basiert auf der gleichen Softwareplattform wie die Lösungen von Saki für 3D-SPI- und 3D-AOI. Die proprietäre Bilderfassung mit High-Speed-Line-Scan überprüft Qualität und Zuverlässigkeit von Lötstellen nach den Tauch-, Selektiv- und Wellenlötungen und verbessert somit auch erheblich die Produktivität. Die Verwendung der gleichen Systemoptionen wie bei den SPI- und AOI-Maschinen von Saki reduziert den Arbeitsaufwand für den Bediener und damit auch die Betriebskosten.

## **Software-Lösungen für die Liniensteuerung**

Mit seiner Software-Suite und den Steuerungssystemen für die Fertigungslinien präsentiert Saki einen sehr innovativen Ansatz zur kontinuierlichen Produktivitätssteigerung auf Basis der erfassten Produktionsdaten. Besucher des Saki-Standes werden die nach IPC-CFX-zertifizierte Kommunikation von Maschine-zu-Maschine live aus erster Hand kennenlernen. Eine weiterentwickelte Funktionalität für die vollständige Linienkontrolle wird durch Sakis Offline Teaching Station (BF2-Editor), Verification Station (BF2-Monitor), Multi Process View und QD Analyzer ermöglicht, die eine weiter verbesserte statistische Prozesskontrolle (SPC) unterstützen.

"Deutschland gilt seit eh und je als ‚Powerhouse‘ der Elektronikherstellung. Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Selecs freuen wir uns sehr, wieder in Deutschland auf





DMG MORI Tokyo Digital Innovation Center 3-1-4,  
Edagawa, Koto-ku, Tokyo  
Phone: +81-3-6632-7910 Fax: +81-3-6632-7915

**Company-Kontakt:**

Hisami Ide

Saki Corporation

E-mail: [ide.hisami@sakicorp.com](mailto:ide.hisami@sakicorp.com)

**Redaktionskontakt:**

Mr. Kim Sauer

miXim PR (Agentur)

Email: [kim@miXimPR.com](mailto:kim@miXimPR.com)

Mobile: +44 7906 019 022